

Family list

1 family member for: JP63131494

Derived from 1 application

- 1 THIN FILM EL DEVICE AND MANUFACTURE OF THE SAME
Publication Info: JP63131494 A - 1988-06-03

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIN FILM EL DEVICE AND MANUFACTURE OF THE SAME

Patent number: JP63131494
Publication date: 1988-06-03
Inventor: SHIMIZU YASUMOTO
Applicant: HOYA CORP
Classification:
- international: H05B33/04; H01L51/52; H05B33/04; H01L51/50; (IPC1-7): H05B33/04
- european:
Application number: JP19860275150 19861120
Priority number(s): JP19860275150 19861120

[Report a data error here](#)

Abstract not available for JP63131494

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-131494

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)6月3日

H 05 B 33/04

6744-3K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

⑮ 発明の名称 薄膜EL素子およびその製造方法

⑯ 特 願 昭61-275150

⑰ 出 願 昭61(1986)11月20日

⑱ 発 明 者 清 水 安 元 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内
 ⑲ 出 願 人 ホーヤ株式会社 東京都新宿区中落合2丁目7番5号
 ⑳ 代 理 人 弁理士 山川 政樹 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

薄膜EL素子およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 透明基板と、この透明基板上に形成された透明電極、誘電体層、EL発光層および背面電極を含むEL薄膜層と、このEL薄膜層を覆つて透明基板上に固着されたキャップとを有する薄膜EL素子において、キャップは、封着剤注入口を備え、るとともに内面に吸湿性材料を固定し、かつ上記封着剤注入口は熱硬化樹脂封着剤により封じてなることを特徴とする薄膜EL素子。

(2) キャップ内面に吸湿性材料を分散させた封着剤を塗布し硬化させて吸湿性材料を固定する工程と、このキャップを、透明電極、誘電体層、EL発光層および背面電極からなるEL薄膜層を設けた透明基板上に固着する工程と、これらキャップおよび透明基板を加熱した状態で、キャップに設けた封着剤注入口に熱硬化樹脂封着剤を注入し硬化させて封止する工程とを含むことを特徴とする薄

膜EL素子の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、平面形ディスプレイ・デバイスとして、コンピュータシステムの請求機器その他の表示装置に、静止画像や動画の表示手段として利用される薄膜EL素子およびその製造方法、特に封じ方法に関する。

〔従来の技術〕

従来この種の薄膜EL(エレクトロルミネセンス)素子は、例えば透明なガラス基板上に、T₀O₂, S₀O₂等からなる透明電極を配列し、次にT₀O₂, T₀O₂等からなる第1の誘電体層、発光中心として0.1~2μmのM₀をドープしたZnS等からなるEL発光層および第2の誘電体層を順次覆層した後、Al, T₀, S₀等からなる背面電極を配列することによつて形成されていた。透明基板側から見ると透明電極と背面電極とが交差する領域がパネルの1像素に相当し、両電極間に交電電圧を印加することにより、M₀発光中心より

特開明63-131494(2)

橙色の発光を呈する。

このようなEL素子は、透明基板上に形成した透明電極から背面電極に至る誘電層（以下EL誘電層という）が外気、特に湿気の影響を受けやすく、空気中の湿気がEL誘電層にわずかに浸透しても、それが誘電体層等のピンホールなどに侵入してその部分の抵抗を下げる。その結果過大な電圧が流れて局部的に発熱することになり、誘電層が基板から剥離したり、結晶破壊を起して素子寿命を低下させることになる。また、侵入した湿気がEL発光層まで到達すると、発光層は水に對してきわめて弱いために劣化して、素子寿命が低下することになる。

そこで、このような湿気から誘電EL素子を保護するために、従来より、①；無機あるいは有機性の被覆でEL誘電層全体を密着して覆う、②；ガラスキャップなどでカバーする、③；④のガラスキャップ中を脱ガス真空化する、⑤；⑥のガラスキャップ中にシリコンオイル等の絶縁性液体を満たす、⑦；⑧に加え、さらにキャップ内腔に水

れらを加熱した状態でキャップの接着剤在入口に熱硬化樹脂接着剤を注入し硬化させて封止する工程とを設けたものである。

〔作用〕

キャップを透明基板上に配着し加熱することにより、内部に残留する湿気が接着剤在入口から追い出されるとともに、外部雰囲気からの湿気の侵入が防止される。封止後、内部に少量の湿気が残留したとしても、その湿気はキャップ内腔に固定された吸湿性材料により吸収される。

〔実施例〕

第2図は、透明基板上に形成したEL誘電層を示し、同図(a)は平面図、同図(b)はその一断面図である。次に、その形成方法を説明する。

まず、アルミノシリケートガラス（ROYA（株）製NA40；寸法100×100×3mm）からなる透明基板1上に、スズ酸化物を蒸着した酸化インジウムを素材にして、真空蒸着法により多数の帯状の透明電極2を形成する。このとき、透明電極2の引出し部は、交互に基板の周縁に向けて延在させる。

分岐取柄としてシリカゲルを塗布したシートを貼設するなどの対策が講じられてきた。

〔発明が解決しようとする問題点〕

上述した各種の防湿対策は、いずれも効果上ならびに製造上の欠点を有する。まず、①はEL素子の放熱を行なうのに不都合で、場合によっては応力の増加による割裂が生ずる。次に、②は効果が不十分である。さらに、③、④、⑤はいずれも製造上の困難性を有し、また特に⑤は外部大気圧とキャップ内部との圧力差のために、素子強度の点でも問題がある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明による誘電EL素子は、内面に吸湿性材料を固定したキャップを用い、かつこのキャップに設けた接着剤在入口を、熱硬化樹脂接着剤により封じしめたものである。

また本発明による製造方法は、キャップ内面に吸湿性材料を分散させた接着剤を塗布し硬化させて吸湿性材料を固定する工程と、EL誘電層を形成した透明基板にキャップを固着する工程と、こ

次に、同様の製造により、酸化イットリウム(Y_2O_3)を素材にして第1の誘電体層3（膜厚3000Å）、活性物質として0.5wt%のマンガン(Mn)をドープした $CaS:Mn$ 誘電ペレットを素材にしてEL発光層4（膜厚6000Å）および第1の誘電体層3と同様の物質を素材にして第2の誘電体層5（膜厚3000Å）を順次形成する。次いで第2の誘電体層5の上に、同様の製造により、アルミニウム(Al)を素材にして、透明電極2と互いに交差する方向に、多数の帯状の背面電極6（膜厚3000Å）を形成する。この背面電極6の引出し部も、基板の周縁に向けて交互に延在させる。引出し部を除いた同電極ならびにその間に介在させたEL発光層および第1、第2の誘電体層により、EL誘電層7が構成される。

第3図は、この透明基板1に固着して用いるキャップ8を示し、同図(a)は平面図、同図(b)はその一断面図、同図(c)は斜視図（ただし裏返し）である。キャップ8は、透明基板1と同様の素材であるアルミノシリケートガラスからなる。各層の

特開明63-131484(3)

寸法は第2図中に示した通り(単位はmm)で、概ね正方形の底面および4つの側面を有する箱形であるが、開放端部に、矩形状の切欠8を設けてある。この切欠8は、後述するように、キャップ8が透明基板5上に固着されたときに蓋着部12入口を構成する。

次に、第1図を用いて、このようなキャップ8を透明基板1に固着して封じする工程を説明する。

はじめに、キャップ8を、100〜200℃(本実施例では150℃)で1時間以上(同2時間)予備加熱し、表面に吸着された湿気を十分に除去する。次に、五酸化二リン(P_2O_5)の微粒子を熱硬化形のエポキシ系接着剤に分散させたペーストを準備し、キャップ8のEL導電層7に固着することになる底面内面に、同ペーストをスクリーン印刷法により約200〜300μmの厚さに塗布した後、ハットプレート等の加熱器に乗せ、100〜200℃(本実施例では150℃)に加熱する。これにより、固化した接着剤10に五酸化二リンの微粒子11が固定された吸湿効果層12が得られる(第1図

形成された透明基板1をそれぞれ予備加熱することによりそれらの表面に吸着された湿気あるいはEL導電層7中に吸着された水分を除去することができ、さらに兩者を重ねた状態で加熱することにより、内部に残留する湿気をキャップ8の切欠8から外部に追い出すことができるとともに、外部雰囲気からの湿気の侵入を防止することができる。また、封じ完了後に内部に少量の湿気が残留したとしても、その湿気は五酸化二リンの微粒子11により吸収されるため、EL導電層7が劣化するなど劣化表示に影響等が及ぶことを防止できる。この五酸化二リンによる吸湿効果は、封じの際に加熱されることから、さらに高められる。また、この五酸化二リンの微粒子11を固定している接着剤は熱硬化形であることから、封じ工程における加熱によつて劣化することはない。

本実施例において、透明基板1およびキャップ8の材質をともにアルミノシリケートガラスとしたが、これに限定されるものではない。例えば石英ガラスやフッ素ガラス等でもよいが、好ましく

(a)。

一方、EL導電層7を形成した透明基板1を、100〜200℃(本実施例では120℃)で1時間以上(同2時間)予備加熱して表面に吸着されたり内部に吸着されたりした湿気を十分に除去する。引続きさらに加熱しながら、この透明基板1上に、前述したキャップ8を、EL導電層7を覆うように所定位置に配置する。このとき、キャップ8の切欠8を除く開放端部に、予め熱硬化形のエポキシ系接着剤を塗布しておくことにより、その接着剤が硬化して形成された固化接着剤13によつて、キャップ8は透明基板1上に固着される(第1図(b))。

次に、これら透明基板1およびキャップ8の加熱をしばらく継続した後、その状態で、キャップ8の切欠8に新たなエポキシ系接着剤を注射器等で注入し、所定時間(本実施例では1時間)加熱し脱ける。これにより、切欠8は、固化接着剤14により封じされる(第1図(c))。

封じに際し、キャップ8およびEL導電層7が

は熱膨張係数の等しいガラスを用いることがよい。このようなガラスとしては、例えばソーダライムガラス等の多成分系ガラスでもよいし、石英ガラスでもよい。

また、熱硬化形樹脂系接着剤は、エポキシ樹脂系接着剤に限らず、シリコン樹脂など、他の耐熱性・耐湿性の樹脂でもよい。

さらに、吸湿性材料としては、五酸化二リンの他に、シリカゲル、塩素酸マグネシウム($Mg(ClO_4)_2$)、酸化アルミニウム(Al_2O_3)、酸化カルシウム(CaO)などを用いてもよい。

なお、矩形状の切欠8の代りに、V字状、U字状等の切欠または円筒状、角筒状等の貫通孔でもよく、その数は1対に限らず、少なくとも1個あればよい。また、貫通孔状の接着剤出入口であれば、キャップ8の側面に限らず、底部に設けてもよい。

さらに、上述した実施例では、底面および側面を一体に形成したキャップを用いたが、これらを別々に形成して組合せてもよい。第6図に、そ

特開昭63-131494(4)

の例を示す。第4図(a)は平面図、同図(b)はそのト
→断面図、同図(c)は斜視図である。

本実施例のキャップ15は、透明基板1と同一
のアルミニウムシリケートガラスからなる板状カバー
15Aの一主面側に、コの字形の枠状のスペーサ
15Bを2個向かい合せて配置した構成を有している。
スペーサ15Bは、板状カバー15Aに熱硬化形
エポキシ系接着剤を塗布し、オープン等で100℃
で加熱硬化させることにより固着形成した。その
際、2個のスペーサ15Bのコの字の開口側を相互
に所定距離 $L=0.8\sim 1.0$ mm(本実施例では3mm)
だけ離間させ、スリット18を構成する。なお、
2個のスペーサの枠内は、BL導電層7の側面を
包囲する大きさを有する。また、その幅寸法 W は
 $0.5\sim 0.8$ mm(本実施例では2mm)が適当である。
高さ寸法 H は、BL導電層7のうちの透明電極2
を除いた金属層と、塗布する固化接着剤の厚さ(通
常20～3000 μm ;本実施例では200～300 μm)
とを合わせた厚さより大きければよく、本実施例で
は1000 μm とした。

次いで、スペーサ15Bの外側面17と板状カバー
15Aおよび透明基板1の対向面11、12とで
構成される空間30に、新たなエポキシ系接着剤
を注射器等で注入し、所定時間(本実施例では1
時間)加熱を続ける。これにより、エポキシ系接
着剤が硬化し、固化接着部21を形成する(第7
図)。固化接着部21は、透明基板1、板状カバー
15Aおよびスペーサ15Bの外側面に固着し、こ
れらを強固に結合している。図では、略して描
いてあるが、固化接着部21の高さ寸法(スペー
サ15Bの高さ寸法と同じ) H は、前述した通り
1000 μm (1mm)にすぎないから、透明基板1と
板状カバー15Aとの間における界面張力を得て、
接着剤は容易に注入される。なお、このときスリ
ット18には接着剤は注入されず、内部空間と外
部雰囲気とはスリット18により通じている。

この状態で、透明基板1およびキャップ15の
加熱をしばらく継続した後、スリット18に新た
なエポキシ系接着剤を注射器等で注入し、所定時
間(本実施例では20分間)加熱し続ける。これ

次に、第5図ないし第8図を用いて、このよう
なキャップ15を透明基板1に固着して封じする
工程を説明する。なお、各図において(a)は第4図
(b)に対応する断面図、(b)は側面図である。

はじめに、キャップ15を100～200℃(本実
施例では120℃)で1時間以上(本実施例では2
時間)予備加熱し、表面に吸着されたり内部に吸
着された湿気を十分に除去する。次に、五酸化二
リン(P_2O_5)の微粒子を熱硬化形のエポキシ系接
着剤に分散させたペーストを、第1図の実施例と
同様の方法により、板状カバー15AのBL導電層
7に面する内面に20～3000 μm (本実施例では
200～300 μm)の厚さに塗布し、硬化させて、
五酸化二リンの微粒子11と固化した導電層10
とからなる吸湿効果層12を得る(第5図)。

一方、BL導電層7を形成した透明基板1も、
第1図の実施例と同様に加熱し、湿気を十分に除
去した後、引続き100～200℃(本実施例では
150℃)で加熱しながら、キャップ15を、BL
導電層7を覆う所定位置に配置する(第6図)。

により、スリット18は固化接着部22により封
止される(第8図)。

本実施例において、透明基板1、板状カバー
15A、熱硬化形樹脂接着剤および吸湿性材料など
が上述した物質に限定されないことは、第1図の
実施例の場合と同様である。

また、各実施例において、吸湿性材料はキャ
ップの底部内面(第5図の実施例では板状カバー
15Aの内面)にのみ固定したが、キャップの側面
内面(第5図の実施例ではスペーサ15Bの内面)
に固定してもよく、キャップ内面全体に固定すれ
ばその吸湿効果をより高めることができることは
いうまでもない。

なお、BL発光層4を第1および第2の誘電体
層3,5で挟んだ構成を示したが、これら第1お
よび第2の誘電体層は、いずれか一方のみでもよ
いことはいうまでもない。

〔発明の効果〕

本発明によれば、内面に吸湿性材料を固定した
キャップを、BL導電層を形成した透明基板に固

特開昭63-131484(5)

層し、接着剤注入口を熱硬化樹脂接着剤で封じ
した構成をとることにより、またその封じを加熱
した状態で行なうことにより、防湿効果の高い薄
膜EL素子が容易に得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第3図は本発明の一実施例を示す
図で、第1図は封じ方法を示す工程断面図、第2
図(a)はEL発光層を形成した透明基板を示す平面
図、同図(b)はその断面図、第3図(a)はキャップを
示す平面図、同図(b)はその断面図、同図(c)
は斜視図、第4図(a)はキャップの他の構成例を示
す平面図、同図(b)はその断面図、同図(c)は
斜視図、第5図～第8図はこのキャップを用いて
の封じ方法を示す工程図で、各図(a)は断面図、各
図(b)は(a)と90°方向の異なる側面図である。

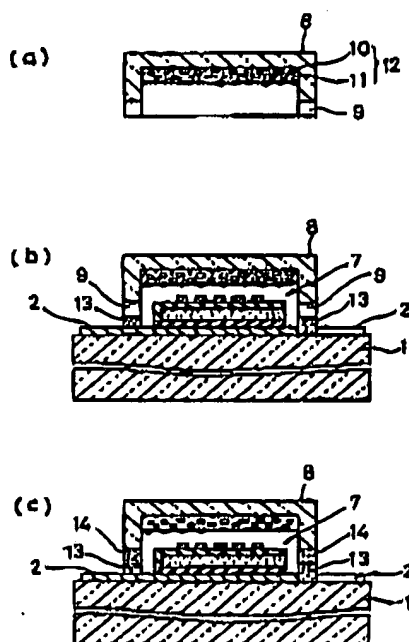
1・・・透明基板、2・・・透明電極、3、
5・・・防湿作層、4・・・EL発光層、6
・・・背面電極、7・・・EL発光層、8、
15・・・キャップ、9・・・切欠（接着剤
注入口）、10・・・固化接着層、11・・・

・吸湿性物質の微粒子、13、14、21、22
・・・固化接着層、16・・・スリット（接
着剤注入口）。

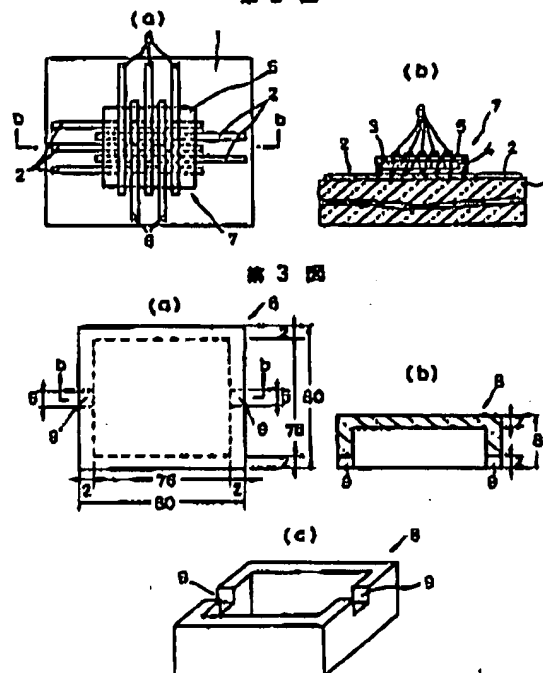
特許出願人 キヤパ株式会社

代理人 山川政樹(ほか2名)

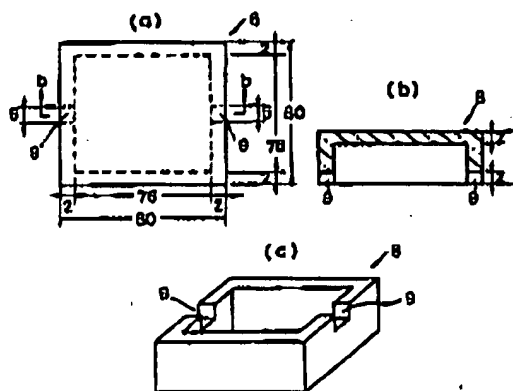
第1図



第2図

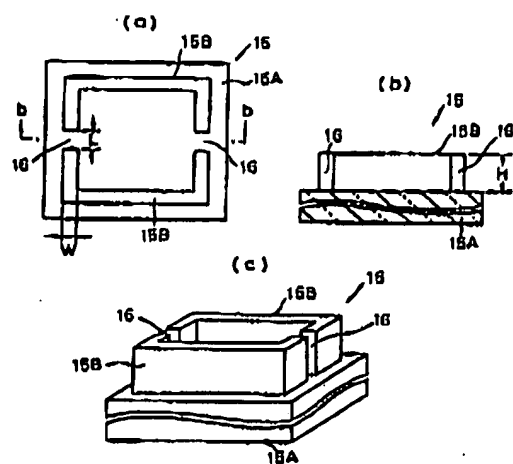


第3図

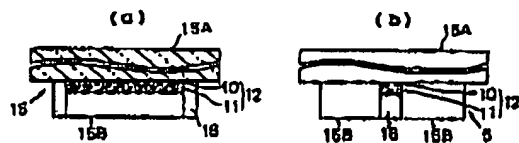


特開昭63-131404 (e)

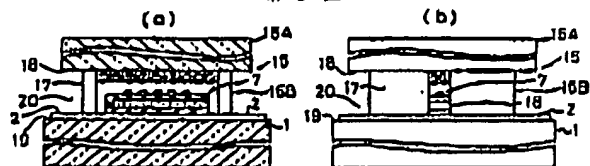
第4図



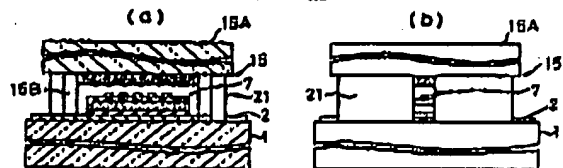
第5図



第6図



第7図



第8図

